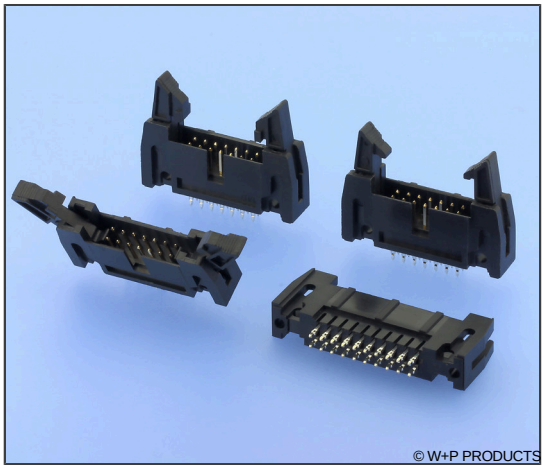
138PF

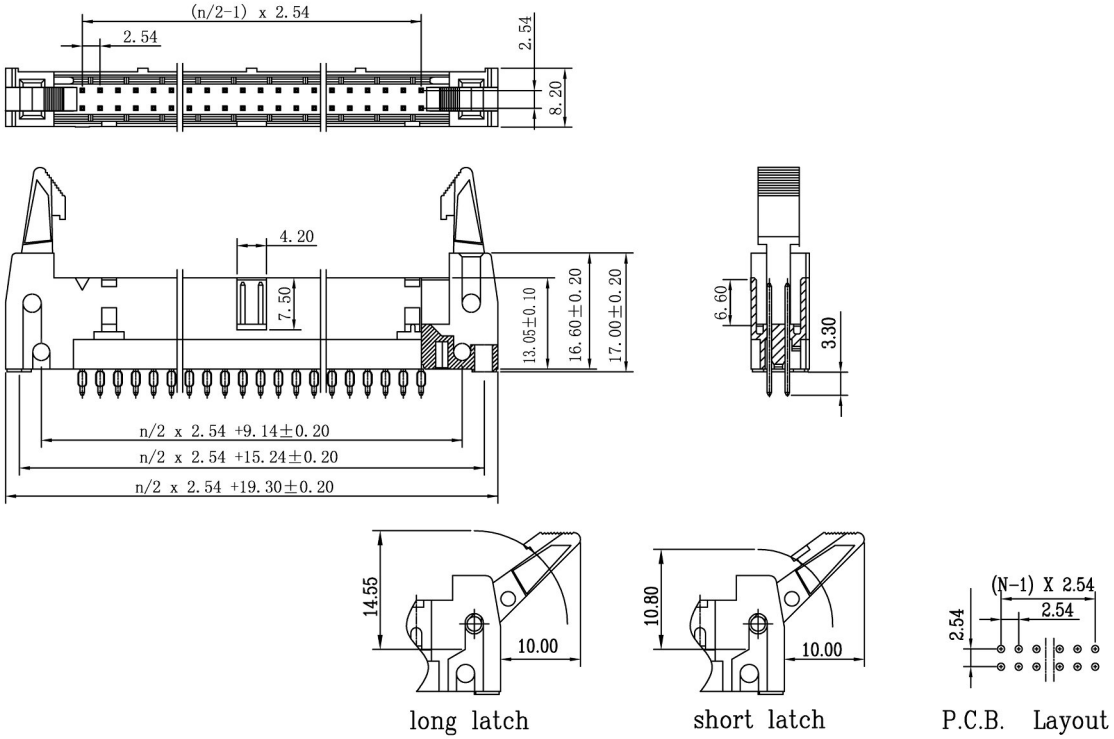
Wannenstiftleisten mit Verriegelung, RM 2,54mm, Press-Fit

Box Headers with Latches, 2.54mm Pitch, Press-Fit

Technische Daten / *Technical Data*

Gehäuse	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Shell	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	*Square pin 0.635mm, copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Withstanding Voltage	*500 V AC*
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	*250 V AC*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +105 °C*
Verarbeitung	Einpresstechnik
Processing	*Press-Fit*





Einpressen über Stiftspitzen.
Press-in over pin tips.

Einpresszone s. Tech. Informationen.
See technical Information for PressFit zones.

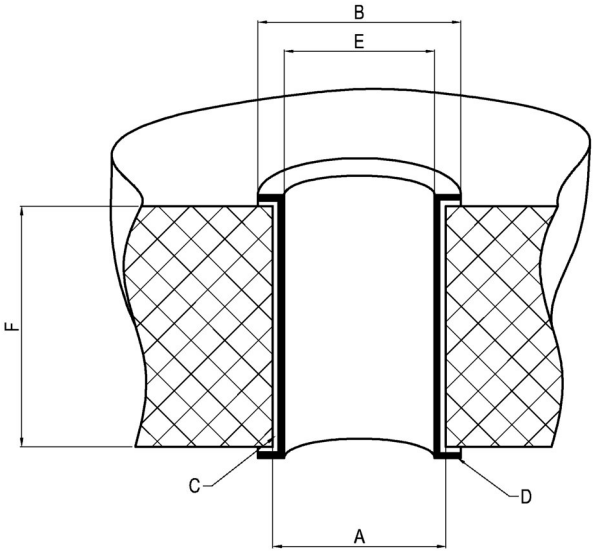
Series	***Contacts****	***Latches****	***Plating****
138PF	**40**	**10**	**60**
	10/14/16/20/26 **34/40/50/60/64**	**00** Ohne Hebel *W/o latches* **10** Kurze Hebel *Short latches* **20** Lange Hebel (für Gegenstecker mit Zugentlastung) *Long latches (for mating connectors with strain relief)*	**00** Vergoldet *Gold plated* **60** Au/Sn *Au/Sn*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

PressFit Lochdefinitionen
PressFit Hole Definitions

Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



A	Bohrungs-Ø	*Base Hole Ø*
B	Ring-Ø	*Ring Ø*
C	Cu-Schicht	*Cu Layer*
D	Veredelung	*Plating*
E	Endloch-Ø	*Final Hole Ø*
F	Leiterplattendicke	*PCB Thinkness*

Serie ***Series***	**RM / *Pitch* [mm]**	**A [mm]**	**B [mm]**	**C [µm]**	**D Option [µm]**		**E [mm]**	**F [mm]**	**Max. PCB-Kräfte** ***Max. PCB Forces***
					Sn	**Au/Ni**			
943PF, 944PF 943PFS, 944PFS	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	$1{,}00^{+0{,}09}_{-0{,}06}$	min. 1,60	in: 150 N per pin
314PF	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60	in: 100 N per pin
153PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	$1{,}00^{+0{,}09}_{-0{,}06}$	min. 1,60	in: 89 N per pin
182PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	$1{,}00^{+0{,}09}_{-0{,}06}$	min. 1,60	in: 89 N per pin
138PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00±0,05	min. 1,60	in: 150 N per pin